

04; 11  
© 1992 г.

## ЭМИССИОННЫЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ ИСТОЧНИКА ЭЛЕКТРОНОВ С ПЛАЗМОЙ, ОГРАНИЧЕННОЙ ПРИСТЕНОЧНЫМ ИОННЫМ СЛОЕМ

В. Л. Галанский, В. А. Груздев, В. И. Зеленский,  
В. В. Илюшенко, И. В. Осипов, Н. Г. Ремле

Проведен анализ характеристик источника электронов на основе эмиссии из плазмы, ограниченной пристеночным ионным слоем, с учетом процессов в эмиссионном канале. Предложены физическая модель и методика, позволяющая рассчитать ВАХ, эмиссионную характеристику и характеристику управления источника в зависимости от параметров плазмы, напряженности поля в ускоряющем промежутке и геометрии эмиссионного канала. Показано, что протекание эмиссионного тока через плазму в канале не приводит к существенному изменению осевого распределения концентрации. Результаты расчетов удовлетворительно согласуются с экспериментальными данными.

Существуют источники электронов, в которых эмиссия частиц происходит с поверхности плазмы, ограниченной пристеночным ионным слоем в эмиссионном канале, выполненном в катоде разрядной камеры [1]. В известных работах, посвященных анализу эмиссионных характеристик плазменных электронных источников, параметры эмиттирующей плазмы в канале считаются неизменными. Однако, проникающая в канал плазма изменяет свои параметры вследствие ухода ионов на стенки [2]. Эмиссия электронов из плазмы может приводить к дополнительному возмущению плазмы в канале. В настоящей работе изложены результаты исследований эмиссионных характеристик плазменного источника электронов с учетом изменения параметров плазмы в канале при отборе электронов.

Анализ возмущения плазмы, обусловленного эмиссией, может быть выполнен в рамках модели, предложенной в [2], где показано, что в отсутствие эмиссии при проникновении плазмы в цилиндрический канал происходит уменьшение ее концентрации  $n(z)$  вдоль оси канала и возникает аксиальное электрическое поле, возвращающее электроны в разрядную камеру. Совокупное влияние этих факторов приводит к возрастанию протяженности пристеночного слоя, который ограничивает проникновение плазмы в канал.

Эмиссия электронов из плазмы возможна как через потенциальный барьер, так и с открытой плазменной поверхности [1]. Очевидно, что во втором случае возмущение должно быть более значительным, поэтому ограничимся только его рассмотрением. Величину эмиссионного тока  $I_e$

с открытой плазменной поверхности радиуса  $r(z_{rp})$ , расположенной на расстоянии  $z_{rp}$  от входа в канал, можно определить как

$$I_e = en(z_{rp})v_e(z_{rp})\pi r^2(z_{rp}), \quad (1)$$

где  $e$  — заряд электрона,  $v_e(z_{rp})$  — средняя скорость эмиттированных электронов.

Появление обусловленного эмиссией осевого тока значительной величины, протекающего через плазму, искажает больцмановское распределение концентрации электронов вдоль оси канала, принятное в [2]. Кроме того, поскольку часть электронов получает возможность покидать плазму в виде эмиссионного тока, то должно ослабевать с увеличением  $I_e$  продольное поле, локализованное в проникающей в канал плазме. Концентрация  $n_0$  и потенциал  $U_n$  плазмы в разрядном промежутке вблизи эмиссионного канала могут изменяться в результате возмущения разряда вследствие известного эффекта переключения тока [3]. Характер этого возмущения и степень изменения  $n_0$  и  $U_n$  зависят, по-видимому, от свойств разряда и величины тока эмиссии [3-5]. Поэтому представляется целесообразным проанализировать влияние отбора электронов на параметры плазмы в канале при фиксированных значениях  $n_0$  и  $U_n$ , а при расчете эмиссионных характеристик конкретных источников учитывать при необходимости эффект изменения  $n_0$  и  $U_n$  введением соответствующей току эмиссии корректировки этих величин. Учет этих соображений позволяет записать систему уравнений для определения осевых распределений параметров плазмы в канале при наличии отбора электронов в виде

$$\eta = \exp(-\varphi) - \frac{I_e}{en_0\pi R^2\rho^2v_e(\xi)}, \quad (2)$$

$$-\frac{d}{d\xi}(\eta\rho^2\sqrt{\varphi}) = -\sqrt{\frac{2}{e_N}}\eta\rho, \quad (3)$$

$$\eta\rho\beta^2(1/\rho) = D\varphi^{3/2}, \quad (4)$$

где

$$\eta = \frac{n(z)}{n_0}, \quad \varphi = \frac{e[U_n - U(z)]}{kT_e}, \quad \rho = \frac{r(z)}{R}, \quad \xi = \frac{z}{R}$$

— безразмерные концентрация, потенциал, радиус плазмы и продольная координата соответственно;  $U(z)$  — потенциал плазмы относительно стенки канала;  $R$  — радиус канала,  $T_e$  — температура электронов в

невозмущенной плазме;  $v_e(\xi)$  — средняя скорость эмиттированных электронов в сечении  $\xi$ ;  $e_N$  — основание натуральных логарифмов;  $D = (4/9)\sqrt{2e_N}((\epsilon_0 kT_e)/(e^2 R^2 n_0))$ ,  $\epsilon_0$  — диэлектрическая постоянная  $\beta^2(1/\rho)$  — функция Ленгмюра в законе „степенная 3/2“ для цилиндрического диода.

Соотношение (2) представляет собой осевое распределение концентрации электронов в предположении бесстолкновительного движения электронов в канале. Второй член в правой части уравнения (2) учитывает уменьшение концентрации по сравнению со случаем отсутствия эмиссии электронов. Величина  $v_e(\xi)$  при этом определяется как

$$v_e(\xi) = \frac{\int_{v_{gp}}^{\infty} \sqrt{v^2 - \sqrt{\frac{2kT_e}{m}\varphi}} \sqrt{\frac{m}{2\pi kT_e}} e^{-\frac{mv^2}{2kT_e}} dv}{\int_{v_{gp}}^{\infty} \sqrt{\frac{m}{2\pi kT_e}} e^{-\frac{mv^2}{2kT_e}} dv}. \quad (5)$$

Здесь

$$v_{gp} = \sqrt{\frac{2kT_e}{m}\varphi_{gp}},$$

где  $\varphi_{gp} = \varphi(\xi_{gp})$  — потенциал на эмиссионной границе плазмы,  $m$  — масса электрона.

Уравнение непрерывности (3) учитывает изменение продольного компонента ионного тока за счет изменения осевой скорости ионов, ухода их на стенки канала и изменения протяженности пристеночного слоя, а следовательно, и радиуса плазмы в канале.

Уравнение (4) — закон „степени 2/3“ для ионов, уходящих на стенки канала. Физический смысл применения этого закона в данном случае заключается в том, что (4) устанавливает равенство между величиной ионного тока из плазмы и пропускной способностью пристеночного слоя.

В качестве граничного условия, позволяющего определить параметры плазмы при  $\xi = \xi_{gp}$ , использовалось равенство (1) для заданной величины эмиссионного тока  $I_e$ . Подставляя (1) в (2), получаем

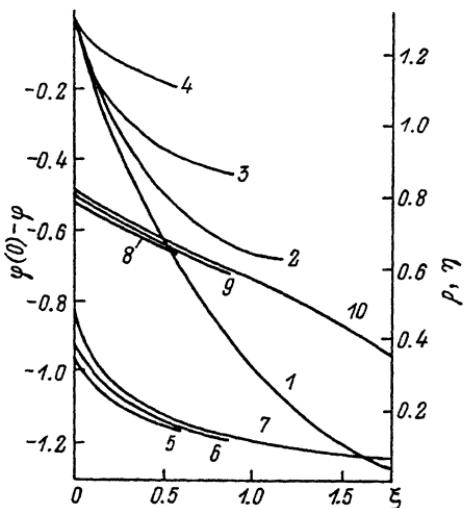
$$2\eta(\xi_{gp}) = \exp(-\varphi_{gp}), \quad (6)$$

т. е. концентрация на границе в условиях эмиссии в два раза меньше концентрации в том же сечении при отсутствии отбора электронов.

Приведенная система уравнений решалась численно, при этом в качестве внешних параметров задавались  $n_0$ ,  $U_n$ ,  $T_e$ ,  $R$ ,  $I_e$ . Диапазоны

Рис. 1. Осевые распределения потенциала (1–4), концентрации (5–7) и радиуса (8–10) плазмы.

$n_0 = 10^{19} \text{ м}^{-3}$ ,  $T_e = 5 \text{ эВ}$ ,  $U_n = 300 \text{ В}$ ,  $R = 1 \text{ мм}$ ,  $\varphi(0) = 0.3$ ;  $I_e$ , мА: 1, 7, 10 – 0; 2 – 93; 3, 6, 9 – 186; 4, 5, 8 – 372.



изменения этих величин соответствовали реальным значениям, реализуемым в плазменных источниках электронов на основе разряда с полым катодом:  $n_0 = 10^{18} - 10^{19} \text{ м}^{-3}$ ,

$U_n = 100 - 700 \text{ В}$ ,  $T_e = 5 \text{ эВ}$ ,  $R = 1 \text{ мм}$ ,  $I_e = 0 - 0.5 \text{ А}$ . Значение потенциала плазмы на выходе в канал  $\varphi(0)$  задавалось равным 0.3–0.5, при этом существенного влияния этой величины на распределение параметров плазмы в канале не обнаружено.

Результаты расчета, представленные на рис. 1, свидетельствуют о том, что возмущение плазмы в канале при эмиссии электронов сводится в основном к снижению градиента потенциала в ней с увеличением  $I_e$ .

В то же время осевые распределения концентрации и радиуса плазмы остаются практически неизменными. Приведенные на рис. 1 зависимости позволяют также определить глубину проникновения плазмы в канал в отсутствие эмиссии электронов и перемещение плазменной границы при возрастании  $I_e$ .

Изменение  $\varphi(\xi)$  с увеличением тока эмиссии находится в согласии с предполагавшимся выше ослаблением продольного поля в проникающей в канал плазме, тогда как неизменность  $\eta(\xi)$ , а следовательно, и  $\rho(\xi)$  при отборе электронов не является столь очевидной. Для проверки этого факта были проведены зондовые измерения концентрации плазмы в эмиссионном канале. Эксперименты показали отсутствие существенной зависимости осевого распределения концентрации плазмы от тока эмиссии, что согласуется с данными численного анализа.

Приведенные результаты позволяют предложить достаточно простую методику расчета вольт-амперных характеристик (ВАХ) плазменного источника электронов. Зависимость  $I_e$  от величины ускоряющего напряжения  $U_y$  может быть рассчитана в соответствии с (1). При этом необходимо учитывать, что в реальных источниках положение эмиттирующей границы плазмы определяется проникновением в канал поля ускоряющего электрода. Увеличение  $U_y$  приводит к перемещению границы в направлении ко входу в канал, соответственно изменяются параметры плазмы. Однако полученная практическая независимость  $\eta(\xi)$  и  $\rho(\xi)$  от  $I_e$  позволяет использовать при расчете ВАХ эти зависимости, определенные из решения системы (2)–(4) при  $I_e = 0$ .

Таким образом, каждая точка расчетной ВАХ может быть получена следующим образом. Из системы уравнений (2) – (4) при  $I_e = 0$  определяется глубина проникновения плазмы в канал  $\xi_{gp}$  и ее параметры на этой границе  $\eta(\xi_{gp})$ ,  $\varphi(\xi_{gp})$ ,  $\rho(\xi_{gp})$ . Для выбранной величины  $U_y$  из решения уравнения Пуассона рассчитывается распределение потенциала ускоряющего поля в канале  $\varphi_y(\rho, \xi)$ . Если значение  $U_y$  достаточно для реализации режима эмиссии с открытой плазменной поверхности, т. е. если выполняется условие

$$\frac{d\varphi_y(\rho, \xi)}{d\xi} \Big|_{\substack{\xi=\xi_{gp} \\ \rho=0}} \geq 0, \quad (7)$$

то плазменная граница может переместиться.

Новое положение границы  $\xi_{gp}^*$  определяется в соответствии с законом „степени 3/2“

$$\eta(\xi_{gp}^*) v_e(\xi_{gp}^*) = c \frac{[\varphi_y(0, \xi_{gp} + h) - \varphi(\xi_{gp}^*)]^{3/2}}{(\xi_{gp} + h - \xi_{gp}^*)^2}, \quad (8)$$

где  $h$  (малая величина) — шаг сетки при решении уравнения Пуассона методом конечных разностей;

$$c = \frac{4\epsilon_0}{9e^2} \sqrt{\frac{2}{m}} \frac{(kT_e)^{3/2}}{n_0 R^2}.$$

Для полученного значения  $\xi_{gp}^*$  определяются параметры плазмы и рассчитывается  $I_e$  в соответствии с (1). На следующем этапе распределение потенциала ускоряющего поля в канале пересчитывается с учетом поправки, вносимой пространственным зарядом пучка эмиттированных электронов, уточняется положение эмиссионной границы плазмы и соответствующая величина  $I_e$ . Этот цикл для каждого значения  $U$  повторяется до тех пор, пока изменение  $\xi_{gp}$  не станет меньше заданной малой величины.

Описанный алгоритм, реализованный на ЭВМ, позволил рассчитать ВАХ источника в режиме эмиссии с открытой плазменной поверхности. Поскольку экспериментально было установлено, что для рассматриваемого типа источника электронов при эффективности извлечения порядка 20 % и  $I_p = \text{const}$  ( $I_p$  — ток разряда) обусловленные эмиссией изменения  $n_0$  и  $U$  не превышали 5 %, вышеупомянутая корректировка этих параметров при расчете ВАХ не производилась.

Сравнение нормированных по максимальному току эмиссии  $I_{e0}$  расчетных ВАХ с экспериментальными показало их удовлетворительное сов-

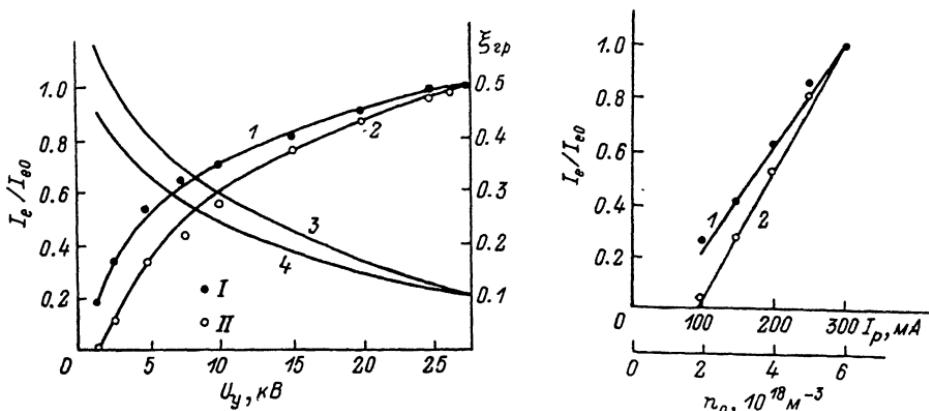


Рис. 2. Зависимости эмиссионного тока (1, 2) и положения эмиттирующей границы плазмы (3, 4) от ускоряющего напряжения.

Точки — эксперимент, сплошные линии — расчет;  $n_0, \text{ м}^{-3}$ : 1, 3 —  $5 \cdot 10^{18}$ ; 2, 4 —  $3 \cdot 10^{18}$ ;  $I_p, \text{ mA}$ : I — 250, II — 150.

Рис. 3. Зависимости эмиссионного тока от концентрации плазмы и тока разряда.

Точки — эксперимент, сплошные линии — расчет.  $U_y, \text{ кВ}$ : 1 — 25; 2 — 5.

падение (рис. 2). Изменение  $n_0$  в эксперименте осуществлялось регулированием тока разряда. Наблюдаемый характер возрастания эмиссионного тока с увеличением  $U_y$  объясняется перемещением границы эмиттирующей плазмы ко входу в канал и соответствующим этому перемещению ростом концентрации эмиттирующей плазмы и площади, с которой реализуется эмиссия. Изменение  $n_0$  изменяет глубину проникновения плазмы в канал в отсутствие отбора электронов, в результате режим эмиссии с открытой плазменной поверхности реализуется, начиная с различных значений  $U_y$ . Перегиб на ВАХ и тенденция к насыщению вызваны, с одной стороны, ограничением проникновения поля ускоряющего электрода в эмиссионный канал и, с другой стороны, экранированием этого поля пространственным зарядом пучка эмиттированных электронов при возрастании  $I_e$ .

Построенные на основе расчетных ВАХ зависимости  $I_e(n_0)$  и экспериментальные характеристики  $I_e(I_p)$  близки к линейным (рис. 3). Рост тока эмиссии с увеличением  $n_0$  (или  $I_p$ ) происходит, как следует из анализа данных численного эксперимента, в результате увеличения  $n(z_{gp})$  и  $r(z_{gp})$ , а положение эмиттирующей границы при этом меняется незначительно. В частности, для использованных размеров канала при  $U_y = 20 \text{ кВ}$  и изменении  $n_0$  от  $10^{18} \text{ м}^{-3}$  до  $6 \cdot 10^{18} \text{ м}^{-3}$   $I_e$  изменяется в пределах от 20 до 130 мА, а перемещение эмиттирующей поверхности

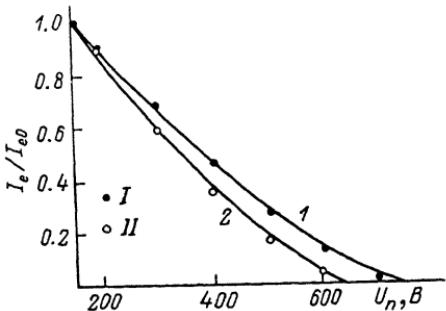


Рис. 4. Зависимости эмиссионного тока от потенциала плазмы.

Точки — эксперимент, сплошные линии — расчет.  $U_n$  — потенциал анода, в;  $n_0^y$  — концентрация ионного слоя,  $\text{м}^{-3}$ ;  $I_p$  — ток, мА: 1 —  $5 \cdot 10^{18}$ ; 2 —  $3 \cdot 10^{18}$ ;  $I_p$  — ток, мА: I — 250, II — 150.

составляет всего 0.1 мм. Этим объясняется слабое влияние „подвижности плазменного эмиттера“ на электронно-оптические параметры пучка при регулировании  $I_p$  изменением  $I_e$ , установленное в<sup>6</sup>.

В работе [7] предполагалось, что при управлении током эмиссии изменением протяженности пристеночного ионного слоя путем варьирования потенциала стенок канала относительно потенциала плазмы концентрация эмиттирующей плазмы постоянна. Однако, как показали расчеты, изменение  $U_n$  приводит не только к изменению площади эмиттирующей поверхности, но и к значительному изменению  $n(z_{gp})$ . Рассчитанные с учетом этого фактора характеристики управления хорошо согласуются с результатами эксперимента (рис. 4), в котором изменение  $U_n$  осуществлялось приложением разности потенциалов между отражательным и полым катодами. Численный анализ показал, что и в этом случае, как и при управлении регулированием тока разряда, изменение  $I_e$  происходит в основном за счет изменения  $n(z_{gp})$  и  $r(z_{gp})$ , а сама величина  $z_{gp}$  изменяется при этом незначительно.

Таким образом, результаты работы показывают, что эмиссия электронов в рассматриваемом диапазоне  $I_e$  не приводит к существенным изменениям осевого распределения концентрации проникающей в канал плазмы. Зависимость тока эмиссии от ускоряющего напряжения при постоянных параметрах плазмы в разряде обусловлена в основном изменением  $n(z_{gp})$  и  $r(z_{gp})$  при перемещении эмиттирующей поверхности под действием поля ускоряющего электрода. Предложенная методика расчета позволяет учсть потери частиц в канале при анализе эмиссионных характеристик источников электронов с плазмой, ограниченной пристеночным ионным слоем.

#### Список литературы

- [1] Завьялов М.А., Крейндель Ю.Е., Новиков А.А., Шантурин Л.П. Плазменные процессы в технологических электронных пушках. М.: Энергоатомиздат, 1989. 256 с.
- [2] Галанский В.Л., Груздев В.А., Зеленский В.И. и др. // ЖТФ. 1990. Т. 60. Вып. 4. С. 168—170.
- [3] Жаринов А.В., Коваленко Ю.А. // ЖТФ. 1986. Т. 56. Вып. 4. С. 681—686.

- [4] Груздев В.А., Осипов И.В., Ремле Н.Г. // Тез. докл. VII Всесоюз. симпозиума по сильноточной электронике. Томск, 1988. Ч I. С. 95—97.
- [5] Крейндель Ю.Е., Никулин С.П., Шубин О.А. // ЖТФ. 1990. Т. 60. Вып. 4. С. 190—191.
- [6] Беляк С.И., Груздев В.А., Крейндель Ю.Е. и др. // Вторая Международная конференция ЭЛТ-88. Варна, 1988. С. 159—164.
- [7] Груздев В.А., Ремле Н.Г. // Изв. АН СССР. Сер. физ. 1982. Т. 46. № 7. С. 1324—1327.

Томский институт автоматизированных  
систем управления и радиоэлектроники

Поступило в Редакцию

18 июля 1990 г.

В окончательной редакции  
20 декабря 1990 г.

---